

การเตรียมพิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริง



นายธนลิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาพิสิกส์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2538

ISBN 974-631-934-5

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Preparation of Thin Films by DC Magnetron Sputtering

Mr. Thanusit Burinprakhon

ศูนย์วิทยบริการ
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
for the Degree of Master of Science
Department of Physics
Graduate School
Chulalongkorn University
1995
ISBN 974-631-934-5

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีเมกนิตรอนสเปคเตอริง
โดย นายธนุสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญศักดิ์ อุย়ৰ্দি
ภาควิชา พลังงาน



บันทึกวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีบันทึกวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ฤทธิราตน)

คณบดีบันทึกวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ฉัตรภรณ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญศักดิ์ อุย়ৰ্দি)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. กิยโย ปันยารชุน)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร เสิงหะพันธุ์)



พิมพ์ดันฉบับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

ชุดที่ บุรินทร์ประโคน : การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอร์ริง (PREPARATION OF THIN FILMS BY DC MAGNETRON SPUTTERING) อ. ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ชจ. ยศ
อยุติ, 192 หน้า, ISBN 974-631-934-5

ได้สร้างระบบเคลือบฟิล์มบางแบบดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอร์ริงซึ่งมีแหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์แบบแมกนิตรอนระนาบวงกลมที่ระบายน้ำร้อนด้วยอากาศ และใช้ในการเตรียมฟิล์มบางของโลหะไมลิบดินนัม และฟิล์มบางของโลหะผสมระหว่างทองแดงกับอินเดียมบนวัสดุรองรับซึ่งเป็นกระจก จากการวัดลักษณะซอของกระแสและความต่างศักย์ของระบบ พบว่า ลักษณะซอนี้ได้รับอิทธิพลจากความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ผิวป่ามาก และมีความสอดคล้องกับสมการทั่วไปในรูป $I = \beta(V - V_0)^2$ ในช่วงความดันกําที่จำกัด เมื่อความเข้มสนามแม่เหล็กคงที่

ฟิล์มบางของโลหะไมลิบดินนัมถูกเตรียมขึ้นจากการสปัตเตอร์เป้าไมลิบดินนัมบริสุทธิ์ ฟิล์มบางของไมลิบดินนัมที่เรียบ สะท้อนแสงดี และสภาพด้านท่านไฟฟ้าต่ำประมาณ 20 ไมโครโอม-เซนติเมตร สามารถเตรียมได้ที่อุณหภูมิของวัสดุรองรับ 100°C ความดันของกําชาร์กอนต่ำกว่า 30 มิลลิโหร์ และความต่างศักย์สูงกว่า 450 โวลท์ ผลการวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์แสดงว่าฟิล์มบางเหล่านี้เป็นผลึกพหุที่จัดเรียงตัวโดยหันหน้า (110) ขนานกับหน้าของวัสดุรองรับ

ฟิล์มบางของโลหะผสมระหว่างทองแดงกับอินเดียมถูกเตรียมขึ้นจากการสปัตเตอร์เป้าทองแดงที่ผิวอินเดียมบนพื้นที่ยังคงสภาพของการสปัตเตอร์ในอัตราส่วนต่างๆ กัน คือ 22, 38, และ 63 เปอร์เซนต์ ที่สภาวะในการเตรียมฟิล์มเดียวกัน พบว่า สภาพด้านท่านของฟิล์มสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนพื้นที่ของอินเดียมบนเป้าเพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของฟิล์มบางของทองแดงและฟิล์มบางของอินเดียม พบว่า ฟิล์มบางที่ได้เป็นโลหะผสมในเฟล็อกฟายของทองแดงที่มีเปอร์เซนต์ของอินเดียมในเนื้อฟิล์มเป็น 6.9, 10.4, และ 12.5 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา ฟิสิกส์
สาขาวิชา ฟิสิกส์
ปีการศึกษา 2537

ลายมือชื่อนิสิต ดูม-พูน ✓
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ชจ. ยศ ✓
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



C325454 : MAJOR PHYSICS

KEY WORD: THIN FILM DEPOSITION / GLOW DISCHARGE / MAGNETRON SPUTTERING

THANUSIT BURINPRAKHON : PREPARATION OF THIN FILMS BY DC MAGNETRON SPUTTERING. THESIS ADVISOR : ASSIST. PROF. KAJORNYOD YODEE, Ph.D. 192 pp.

ISBN 974-631-934-5

A dc magnetron sputtering system for thin film coating with an air-cooled circular planar magnetron sputtering source was constructed and used for preparation of molybdenum thin films and Cu-In alloy thin films on glass substrates. I-V characteristics of the system were measured and found to be strongly influenced by the magnetic field intensity at the target surface. The I-V relation was fitted to a general expression $I = \beta(V - V_0)^2$ within a limited range of argon pressures as the magnetic field intensity was kept constant.

Thin films of molybdenum were prepared from sputtering of a pure molybdenum target. The films of high smoothness, good reflectivity, and low resistivity of about $20 \mu\Omega\text{-cm}$ were obtained under sputtering conditions with a substrate temperature of 100°C , a pressure lower than 30 mtorr, and a discharge voltage higher than 450 volts. XRD patterns showed that these good quality thin films were polycrystalline with a strong (110) preferred orientation.

Thin films of Cu-In alloy were prepared from sputtering of three Cu-In composite targets, which were designed to contain In in an effective sputtered area with the ratio of 22%, 38%, and 63%, under the same conditions. Resistivity of the thin films obtained was found to increase as the area ratio increased. It was shown, by comparing XRD patterns of these films to those of individual Cu and In films, that all films contained α -phase Cu with a corresponding content of 6.9, 10.4, and 12.5 atomic percent of In, respectively.

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา ฟิสิกส์

ลายมือชื่อนิสิต

สาขาวิชา ฟิสิกส์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2537

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชรยศ อุดมดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงศ์ ฉัตรภรณ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ ติดตามและควบคุมการวิจัยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจแก้ไขข้อเขียนวิทยานิพนธ์ จึงถึงได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอาจารย์พงษ์ ทรงพงษ์ และคณะวิจัยพิสิกส์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาพิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการด้านพิสิกส์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยและค่านวายความสะท้อนในการวิจัย

ขอขอบพระคุณอาจารย์ชนา พิวัล่อง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการออกแบบแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เรียนศึกษาอยู่ทั้งในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผู้เรียนได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท). จึงควรขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ในระหว่างปฏิบัติงานวิจัยผู้เขียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง จากโครงการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง ซึ่งดำเนินการวิจัยโดยคณะวิจัยฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ที่นี้ด้วย

ขอขอบพระคุณ คุณประเสริฐ เรียวพิมพา เจ้าน้าที่ประจำภาควิชาธรณีวิทยา ที่ได้ร่วมงานและอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เรียดฟเฟรอกโดยมีเตอร์เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ คุณสมฤทธิ์ วงศ์มณีหารน์ และคุณชาญวิทย์ จิตยุทธการ นิติบัตรชัย ที่ให้ความช่วยเหลือในการออกแบบแบบสร้างเครื่องมือ รวมทั้งคำเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ท้ายนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่เคยให้กำลังใจตลอดเวลาจน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๓
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๔
กิตติกรรมประกาศ	๖
สารบัญตาราง	๗
สารบัญรูป	๗
บทที่ 1 บทนำ	๑
บทที่ 2 ดีซีโกลาดิศษาร์ฯ	๔
การกำเนิดดีซีโกลาดิศษาร์ฯ	๕
อัจฉริยะของอนุภาคในโกลาดิศษาร์ฯ และการรักษาสภาพการดิศษาร์ฯ	๑๑
1. การชนกันของอนุภาคภายในโกลาดิศษาร์ฯ	๑๑
2. การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ	๑๕
3. กลไกรักษาสภาพการดิศษาร์ฯ	๒๐
การกระจายความต่างศักย์และสนานไฟฟ้าในดีซีโกลาดิศษาร์ฯ	๒๑
ลักษณะสื่อกระแส ความต่างศักย์ และความดันของดีซีโกลาดิศษาร์ฯ	๒๗
ดีซีโกลาดิศษาร์ฯ ภายใต้อิทธิพลของสนานแม่เหล็ก	๓๑
1. สนานแม่เหล็กตั้งฉากกับผิวภาชนะ	๓๓
2. สนานแม่เหล็กขนานกับผิวภาชนะ	๓๕
บทที่ 3 การเคลือบฟิล์มบางโดยวิธีสเป็ตเตอริง	๓๙
ทฤษฎีเบื้องต้นของสเป็ตเตอริง	๓๙

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
1. อันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นหากกับพื้นผิว	39
2. กลไกสปัตเตอริง	41
3. อัตราสปัตเตอริง	42
4. เทคนิคสปัตเตอริงและการประยุกต์	47
การเคลือบพิล์มบางโดยวิธีสปัตเตอริง	48
1. หลักการเบื้องต้น	48
2. โครงสร้างระบบเคลือบพิล์มบางโดยวิธีสปัตเตอริง	50
3. อัตราเคลือบพิล์ม	52
4. โครงสร้างจุลภาคของพิล์มบาง	54
ระบบสปัตเตอริงแบบดีซีแมกนิตرون	58
1. อิทธิพลของสนามแม่เหล็กต่อลักษณะส่อของการดิสcharج	58
2. อิทธิพลของสนามแม่เหล็กต่ออัตราเคลือบพิล์ม	60
3. ประเภทของระบบดีซีแมกนิตرونสปัตเตอริง	60
4. ลักษณะส่อกระแสและความต่างศักย์ของระบบสปัตเตอริง แบบดีซีแมกนิตرون	65
รายละเอียดเชิงปฏิบัติการของระบบสปัตเตอริงแบบดีซีแมกนิตرون	70
1. แหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์	70
2. กากสำหรับการสปัตเตอร์และระบบสูญญากาศ	71
3. แท่นวางวัสดุรองรับ	72
4. การเลือกสภาพการสปัตเตอร์	72

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การสร้างเครื่องมือ	73
ภาษาและสุนทรียภาพ	74
1. ผนังด้านข้าง	75
2. ฝ่าครอบด้านบน	75
3. ฐานรอง	76
4. แหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์	80
5. แท่นวางวัสดุรองรับ	85
6. หน้ากาก	86
ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไฟล์ทสูง	88
1. หลักการทำงานของวงจรจำกัดกระแส	89
2. การทดสอบการทำงานของวงจรจำกัดกระแส	92
ระบบสุนทรียภาพ	94
บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง	95
การศึกษาลักษณะสื่อของกระแส ความต่างศักย์และความดันของกรดดิสชาร์จ	95
1. อิทธิพลของสนามแม่เหล็กต่อการดิสชาร์จ	96
1.1 ข้อมูลจำเพาะของแม่เหล็ก	96
1.2 ความต่างศักย์พังทลาย	101
1.3 สถานะหลังการพังทลายและการควบคุม	103
1.4 ขอบเขตการเพิ่มกระแสและลดความดันก้าช	104
1.5 สรุปผลเบื้องต้น	107

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2. การวัดลักษณะสื่อของกราฟ ความต่างศักย์ และความดัน	108
2.1 ข้อมูลจากการทดลอง	108
2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟกับความต่างศักย์	116
3. สรุป	123
การศึกษาการเตรียมพิล์มนิ่งในลิบดินัม	124
1. การเตรียมวัสดุรองรับพิล์ม	124
2. การปฏิบัติทดลอง	125
3. การวิเคราะห์สมบัติของพิล์ม	126
3.1 การคำนวนความหนาของพิล์ม	126
3.2 การวัดสภาพด้านท่านไฟฟ้าของพิล์ม	127
3.3 การตรวจสอบโครงสร้างผลึกของพิล์ม	128
3.4 การวิเคราะห์ลักษณะผิวน้ำและองค์ประกอบของพิล์ม	128
4. ผลการทดลอง	128
4.1 อัตราการเคลือบพิล์ม	128
4.2 การเก่าตัวของพิล์ม	129
4.3 สภาพด้านท่านไฟฟ้าของพิล์ม	130
4.4 โครงสร้างผลึก ลักษณะผิวน้ำและส่วนประกอบของพิล์ม	131
5. การอภิปรายและสรุปผล	134

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การศึกษาการเตรียมพิล์มบางของให้เหมาะสมท่องดังกับอินเดียม	135
1. การสร้างเป้าของกาสปีตเตอร์	135
2. สภาพของการเคลือบพิล์ม	138
3. ผลการทดลอง	139
3.1 ความหนาและอัตราการเคลือบพิล์ม	139
3.2 ลักษณะผิวน้ำและสภาพด้านทันของพิล์มบาง	140
3.3 ผลการวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์	141
4. การวิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลอง	143
5. สรุปผลการทดลอง	145
บทที่ 6 สรุป	147
รายการอ้างอิง	150
ภาคผนวก	156
ภาคผนวก ก แบบจำลองลูกบีบเลียด	157
ภาคผนวก ข ระบบวัดความเข้มสนานแม่เหล็ก	164
ภาคผนวก ค การวัดความหนาพิล์มบางโดยวิธีทางสกี	166
ประวัติผู้เขียน	170

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิเนื่องจากการชน ของไอโอดินบวกของอาร์กอนบนเป้า 4 ชนิดคือ โมลิบดีนัม(Mo) ทังสเทน(W) ชิลิกอนระบนาบ(110) และ นิกเกิลระบนาบ(111) ชิลิกอนระบนาบ(110) และ นิกเกิลระบนาบ(111)	15
ตารางที่ 2.2 ค่า B และ V_0 ของกราฟที่ได้จากการ fit ข้อมูลตามรูปที่ 2.14	31
ตารางที่ 3.1 พลังงานปั๊ดเริ่มของการสปั๊ตเตอร์ (อิเล็กตรอนไอล์ฟ) (H คือ พลังงานสำหรับการระเหิด)	45
ตารางที่ 3.2 อัตราสปั๊ตเตอร์ของโลหะซึ่งชนด้วยไอโอดินบวกของนิโอนและอาร์กอน	46
ตารางที่ 3.3 ค่า β และ V_0 ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ลักษณะส่อกระแทก และ ความต่างศักย์ของโกลด์ิตซาร์จในระบบดีซีเมกนิตรอนสปั๊ตเตอร์ แบบ rectangular-planar magnetron และ Research-S Gun ที่ความดันกําของอาร์กอนต่างๆกัน	69
ตารางที่ 5.1 ขนาดของแม่เหล็กวงแหวนที่จะใช้กับแหล่งกำเนิด การสปั๊ตเตอร์แบบที่ 1	96
ตารางที่ 5.2 ความต่างศักย์พังทลายของการดิสซาร์จที่ความดัน ต่างๆกันภายในได้สนานแม่เหล็กจากแม่เหล็กอันที่ 2	101
ตารางที่ 5.3 แสดงค่าความดันต่ำสุดที่ยังสามารถให้กระแส การดิสซาร์จขนาด 50 มิลลิแอมเปอร์	105
ตารางที่ 5.4 แสดงค่า β และ V_0 ที่ให้ความสอดคล้องดีที่สุด สำหรับข้อมูลในรูปที่ 5.7 และ รูปที่ 5.8	117
ตารางที่ 5.5 แสดงค่า β และ V_0 ที่ให้ความสอดคล้องดีที่สุด สำหรับข้อมูลในรูปที่ 5.9 และ รูปที่ 5.10	118

สารบัญตาราง(ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 5.6 แสดงค่า β และ V_0 ที่ให้ความสอดคล้องดีที่สุด สำหรับข้อมูลในรูปที่ 5.12 และ รูปที่ 5.13	119
ตารางที่ 5.7 ความหนาและอัตราเคลือบฟิล์ม	140
ตารางที่ 5.8 ค่าคงที่ของผลึกที่ได้จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ในรูปที่ 5.30x รูปที่ 5.30c และรูปที่ 5.30g	144
ตารางที่ 5.9 เปอร์เซนต์ของอินเดียมในเนื้อฟิล์มที่ได้จาก เป้าที่ผงอินเดียมหั้งสามอัตราส่วน	145

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญรูป

หน้า	
รูปที่ 2.1 ระบบดีซีโกลาดิสชาร์จอย่างง่าย	5
รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสและความต่างศักย์ ของดีซีโกลาดิสชาร์จในระบบซึ่งใช้กําชันของความดัน 1 Torr.	6
รูปที่ 2.3 เส้นโค้งพาราเซนแสดงความต่างศักย์พังทลายของกาซระหว่างขั้วไฟฟ้า สองขั้วอยู่ห่างกันเป็นระยะ d (cm) ที่ความดัน P (torr) คำนวนจาก สมการที่ (2.2) เส้นที่ 1 ได้จากค่า $A=2500$ Volt/(torr x cm) $C=2.18$ เส้นที่ 2 ได้จาก $A=2250$ Volt/(torr x cm) $C=1.98$ และเส้นที่ 3 ได้จาก $A=2000$ Volt/(torr x cm) $C=1.78$	8
รูปที่ 2.4 ลักษณะของดีซีโกลาดิสชาร์จขณะที่สามารถรักษาสภาพการดิสชาร์จ ได้เอง (ความเข้มของการกระแสแสดงถึงความเข้มของการโกลา)	10
รูปที่ 2.5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิจากโลหะ ทั้งสูงและไม่สูง เมื่อชนด้วยไอน้ำบางของกาซเจือยอดลังงาน 0-1000 อิเล็กตรอนไอลท์	16
รูปที่ 2.6 การเปลี่ยนแปลงของ γ ตามพลังงานในการชนของไอน้ำบางของ)argonบนผิวโลหะที่หันหน้าระนาบต่างๆ กัน คือ (111) (100) และ (110) a) นิกิล b) อรูมินัม c) เงิน d) ไมล์บินัม	17
รูปที่ 2.7 สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยอิเล็กตรอนสำหรับการชนของไอน้ำบาง อิเลียมและนีออนบนผิวทั้งสูงและไม่สูง ขณะที่เกิดขั้นเดียวกันในไตรเจน	18
รูปที่ 2.8 สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยอิเล็กตรอนสำหรับการชนของไอน้ำบาง argonบนผิวทั้งสูงและไม่สูงที่ปักคุณด้วยขั้นเดียว ของไนโตรเจน	18

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2.9 การกระจายพลังงานของอิเล็กตรอนทุติยภูมิที่หลุดจากผิวโลหะ ในลิบดินัม เนื่องจากการชนโดยไอออนบวกของกาซเชือย พลังงาน 40 อิเล็กตรอนโวลท์	19
รูปที่ 2.10 การกระจายพลังงานของอิเล็กตรอนทุติยภูมิที่หลุดจากผิวโลหะ ในลิบดินัมนึ่งจากการชนด้วยไอออนบวกของอีเลี่ยมพลังงาน ระหว่าง 10-1000 อิเล็กตรอนโวลท์	19
รูปที่ 2.11 แสดงขั้นของ positive space charge ใน sheath region (รูปบน) และ floating potential (V_f) บริเวณผิวน้ำของพื้นผิวที่สัมผัสกับพลาสม่า (รูปล่าง)	24
รูปที่ 2.12 แสดงศักย์ไฟฟ้าในส่วนต่างๆของดีซีไอลวดิสชาร์จรวมทั้งระดับของ floating potential บนผิวที่ไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั่วไปให้สัมผัสกับ การดิสชาร์จ	26
รูปที่ 2.13 ลักษณะสนามไฟฟ้าในดีซีไอลวดิสชาร์จ	28
รูปที่ 2.14 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสและความต่างศักย์ของ ดีซีไอลวดิสชาร์จในบรรยากาศดาวกอน และอุณหภูมิความดันต่างๆกัน เปรียบเทียบผลการทดลองกับผลการคำนวนทางทฤษฎีตามสมการ $V = BJ^{2/3} + V_0$	30
รูปที่ 2.15 ขนาดและพิศทางของแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่กระทำต่ออิเล็กตรอน ซึ่งมีความเร็ว จ. ทำมุน 0 กับสนามแม่เหล็ก (B) (ความเร็วอิเล็กตรอนและ สนามแม่เหล็กอยู่บนระนาบของหน้ากระดาษ)	33

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2.16 อิทธิพลของสนามไฟฟ้า(E) และสนามแม่เหล็ก(B)ต่อการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอน
ก. อิเล็กตรอนถูกเร่งตรงไปยังขาในดเมื่อ B ขนานกับ E และ $\theta=0$
ข. อิเล็กตรอนโคจรเป็น helix ระยะ pitch เพิ่มขึ้น เมื่อ B ขนานกับ E และ $\theta\neq0$
ค. อิเล็กตรอนโคจรเป็น helix ระยะ pitch คงที่ เมื่อ $B\neq0$, $E=0$ และ $\theta\neq0$	34
รูปที่ 2.17 การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนซึ่งหลุดจากผิวคาโซดด้วยความเร็ว v เข้าสู่บริเวณของสนามแม่เหล็ก B ซึ่งมีทิศขนานกับผิวคาโซด (พุ่งเข้าหน้ากระดาษ) และสมมุติว่าไม่มีสนามไฟฟ้า	35
รูปที่ 2.18 การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่ถูกดึงดูดจากผิวคาโซดด้วยความเร็ว v เข้าสู่บริเวณของสนามแม่เหล็ก B ซึ่งมีความเช่นกันที่และทิศขนานกับ ผิวคาโซด (พุ่งเข้าหน้ากระดาษ) และสนามไฟฟ้าซึ่งขนาดลดลงแบบ เชิงเส้นกับระยะจากคาโซดและทิศพุ่งเข้าหากาโซด	36
รูปที่ 3.1 กลไกที่เกิดขึ้นเมื่อไอออนบางชนิดกับผิวเป้า	40
รูปที่ 3.2 การสปัตเตอร์เปรียบเทียบกับการเล่นบิลเลียด	41
รูปที่ 3.3 การถ่ายทอดโนเมนตัมในกระบวนการสปัตเตอร์	42
รูปที่ 3.4 ลักษณะแบบฉบับของความต้มต้นพันธ์ระหว่างอัตราสปัตเตอร์กับ พลังงานไอออนบาง	44
รูปที่ 3.5 ระบบดีซีไดโอดสปัตเตอร์	49
รูปที่ 3.6 ลักษณะทั่วไปของระบบเคลือบฟิล์มบางโดยการสปัตเตอร์	51
รูปที่ 3.7 อัตราเคลือบฟิล์มในระบบสปัตเตอร์แบบแมกนิตرونนานาบ	54

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.8	แบบจำลองโซน(Zone model)แสดงอิทธิพลของอุณหภูมิของวัสดุรองรับ และความดันกําชาร์กอน ที่มีต่อโครงสร้างของฟิล์มบางของโลหะที่ เคลือบโดยวิธีสปัตเตอร์วิ่ง	55
รูปที่ 3.9 ก.	แหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์แบบ cylindrical-post magnetron	61
	ข. ระบบเคลือบฟิล์มที่ใช้ cylindrical-post magnetron	61
รูปที่ 3.10	แหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์แบบ cylindrical-hollow magnetron	62
รูปที่ 3.11	แหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์แบบ circular-planar magnetron	
	ก. ภาพภาคตัดขวางแสดงการวางแผนแม่เหล็กและแนวเส้นแรงแม่เหล็ก	
	ข. แสดงแนวของ $E \times B$ บนผิวเป้า	63
รูปที่ 3.12	การกระจายความหนาของฟิล์มบางจากแหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์ แบบแมgnิตอรอนระนาบวงกลมบนระนาบของวัสดุรองรับที่ห่างจาก ผิวเป้าระยะต่างๆกัน	63
รูปที่ 3.13	แหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์แบบ rectangular-planar magnetron	64
รูปที่ 3.14	ระบบเคลือบฟิล์มบางบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งใช้แหล่งกำเนิด การสปัตเตอร์แบบ rectangular-planar magnetron เป็นชุด	64
รูปที่ 3.15	ภาพภาคตัดขวางของแหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์ แบบ conical magnetron หรือ S-GUN	65
รูปที่ 3.16	ภาพภาคตัดขวางของแหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์แบบ แมgnิตอรอนระนาบวงกลม	71
รูปที่ 4.1	ส่วนประกอบของระบบดีซีแมgnิตอรอนสปัตเตอร์	74
รูปที่ 4.2	ขนาดของห้อแก้วที่ใช้เป็นผังด้านข้างของภาชนะสูญญากาศ	75

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.3 ภาพภาคตัดขวางของฝาครอบด้านบน	76
รูปที่ 4.4 ภาพภาคตัดขวางของฐานรอง	76
รูปที่ 4.5 การติดตั้งห้องน้ำ kaz อาร์กอน	77
รูปที่ 4.6 ช่องติดหัววัดความดัน kaz และการติดตั้งบนฐานรอง	78
รูปที่ 4.7 การติดตั้งห้องน้ำร้อยความร้อน	79
รูปที่ 4.8 ขั้วต่อไฟฟ้าและการติดตั้งบนฐานรอง	79
รูปที่ 4.9 แหล่งกำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 1	80
รูปที่ 4.10 ภาพถ่ายแสดงเป้าที่ติดเรียบร้อยแล้ว	81
รูปที่ 4.11 การติดตั้งแหล่งกำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 1	81
รูปที่ 4.12 (บน) แหล่งกำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 2 (ล่าง) การติดตั้งบนฝาครอบด้านบน	82
รูปที่ 4.13 แหล่งกำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 3	83
รูปที่ 4.14 การติดตั้งแหล่งกำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 3	84
รูปที่ 4.15 ภาพถ่ายของแหล่งกำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 3 ซึ่งติดตั้งบนฝาครอบบนของภาชนะสุญญาการ	85
รูปที่ 4.16 ภาพภาคตัดขวางของแท่นวางวัสดุรองรับ	86
รูปที่ 4.17 ภาพถ่ายของแท่นวางวัสดุรองรับและน้ำจากการติดตั้งอยู่ใน ภาชนะสุญญาการ	87
รูปที่ 4.18 ภาพวาดหน้ากาก	87
รูปที่ 4.19 วงจรกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงไวล์ฟรู๊ง	88

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.20 วงจรเครื่องจำกัดกระแส	89
รูปที่ 4.21 ภาพถ่ายวงจรจำกัดกระแสซึ่งประกอบสำเร็จ	91
รูปที่ 4.22 การต่อวงจรจำกัดกระแสแก้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงไว้ลทสูง และขั้วของการดิสชาร์จ	91
รูปที่ 5.1 การระบุตำแหน่งในการวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก	97
รูปที่ 5.2 กราฟแสดง B_x และ B_y ของแม่เหล็ก 1 (ไม่มีแกนเหล็ก)	97
รูปที่ 5.3 กราฟแสดง B_x และ B_y ของแม่เหล็ก 2 (มีแกนเหล็ก)	98
รูปที่ 5.4a กราฟแสดง B_x และ B_y ของแม่เหล็ก 3 (ไม่มีแกนเหล็ก)	98
รูปที่ 5.4b กราฟแสดง B_x และ B_y ของแม่เหล็ก 3 (มีแกนเหล็ก)	99
รูปที่ 5.5a กราฟแสดง B_x และ B_y ของแม่เหล็ก A (ไม่มีแกนเหล็ก)	99
รูปที่ 5.5b กราฟแสดง B_x และ B_y ของแม่เหล็ก A (มีแกนเหล็ก) [50,51]	100
รูปที่ 5.6 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กในบริเวณหนีอผิวเป้า	100
รูปที่ 5.7 ลักษณะสื่อ I-V จากแหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์แบบที่ 1 และแม่เหล็ก 1 ที่ความดัน 90 มิลลิโตร์	108
รูปที่ 5.8 ลักษณะสื่อ I-V จากแหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์แบบที่ 1 และแม่เหล็ก 2 ที่ความดันกาการ์กอน 90, 70, 50, 35 และ 30 มิลลิโตร์	109
รูปที่ 5.9 ลักษณะสื่อ I-V จากแหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์แบบที่ 2 เมื่อเป้า ⁺ ในลิบดินมหนา 0.2 มิลลิเมตร ที่ความดัน กาการ์กอน 1, 10, 20, 30, และ 50 มิลลิโตร์	111

สารบัญชุป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 5.10 ลักษณะส่อ I-V จากแหล่งกำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 2 เป้าโนลิบดินม หนา 2 มิลลิเมตร ที่ความดันกําชาร์กอน 20, 30, 40, 50 และ 60 มิลลิโหร์	111
รูปที่ 5.11 การวางตัวคันระหว่างแม่เหล็กกับแท่นยึดเป้าบนแหล่ง กำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 2	112
รูปที่ 5.12 ลักษณะส่อ I-V จากแหล่งกำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 2 เมื่อเป้าโนลิบดินม หนา 0.2 มิลลิเมตร ที่ความดัน 20 มิลลิโหร์ และยกแม่เหล็กด้วยตัวคันขนาด 0.8, 1.0 และ 1.2 มิลลิเมตร	113
รูปที่ 5.13 ลักษณะส่อ I-V จากแหล่งกำเนิดการสปีดเตอร์แบบที่ 2 เมื่อเป้าโนลิบดินม หนา 0.2 มิลลิเมตร ที่ความดัน 30 มิลลิโหร์ และยกแม่เหล็กด้วยตัวคันขนาด 0.8, 1.0 และ 1.2 มิลลิเมตร	113
รูปที่ 5.14 เปรียบเทียบลักษณะส่อ I-V ที่ความดัน 90 มิลลิโหร์ ระหว่างข้อมูล จากรูปที่ 5.7 (B_x สูงสุด 165 เกาส์) กับข้อมูลจากรูป 5.8 (B_x สูงสุด 278 เกาส์)	115
รูปที่ 5.15 เปรียบเทียบลักษณะส่อ I-V ที่ความดัน 20, 30 และ 50 มิลลิโหร์ ระหว่างข้อมูลจากรูปที่ 5.9 (B_x สูงสุด 500 เกาส์) กับข้อมูลจากรูป 5.10 (B_x สูงสุด 300 เกาส์)	115
รูปที่ 5.16 เปรียบเทียบลักษณะส่อกระแสงและความต่างศักย์ของรูปที่ 5.10 ที่ความดัน 20 มิลลิโหร์ กับลักษณะส่อที่สอดคล้องดีที่สุดซึ่งได้ จาก β และ V_0 ตามตารางที่ 5.6	120
รูปที่ 5.17 เปรียบเทียบลักษณะส่อกระแสงและความต่างศักย์ของรูปที่ 5.8 ที่ความดัน 50 มิลลิโหร์ กับลักษณะส่อที่สอดคล้องดีที่สุดซึ่งได้ จาก β และ V_0 ตามตารางที่ 5.4	121

สารบัญชุป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 5.18	เปรียบเทียบลักษณะสื่อกราฟและความต่างศักย์ของรูปที่ 5.9 ที่ความดัน 10 มิลลิ托ร์ กับลักษณะสื่อที่สอดคล้องดีที่สุดซึ่งได้ จาก β และ V_0 ตามตารางที่ 5.6	121
รูปที่ 5.19	เปรียบเทียบลักษณะสื่อกราฟและความต่างศักย์ของรูปที่ 5.8 ที่ความดัน 90 มิลลิ托ร์ กับลักษณะสื่อที่สอดคล้องดีที่สุดซึ่งได้ จาก β และ V_0 ตามตารางที่ 5.4	122
รูปที่ 5.20	การทำข้าวส้มผัสด้วยฟื้นฟ้านพิล์ม พร้อมกับแสดงจุดสำหรับการอ้างอิง	127
รูปที่ 5.21	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเคลือบฟิล์มกับกำลังไฟฟ้าของการดิสชาร์จที่ ความดันกากซ์อร์กอน 10 มิลลิโทร์(ข้อมูลจากแหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์ แบบที่ 2)	129
รูปที่ 5.22	ภาพถ่ายเปรียบเทียบระหว่างฟิล์มที่ลอก (ขี้ย)	
	กับฟิล์มที่เรียบติดกระจาก (ขวา)	130
รูปที่ 5.23	ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพด้านท่านไฟฟ้ากับความดันกากซ์อร์กอน	131
รูปที่ 5.24	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีอิเล็กซ์ของฟิล์ม Mo เตรียมที่ความดันต่างๆ เทียบกับของแผ่น Mo ที่ใช้เป็นเป้า	132
รูปที่ 5.25	ภาพผิวน้ำของฟิล์มเตรียมที่ความดัน 10 มิลลิโทร์ ที่ถ่ายจาก กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	133
รูปที่ 5.26	スペคตัรัมของการวิเคราะห์ด้วย EDXS กับฟิล์มเตรียมที่ ความดัน 10 มิลลิโทร์	134
รูปที่ 5.27ก	ภาพถ่ายของเป้าทางแดง (วงแหวนสีเข้มรอบจุดศูนย์กลางเป้า ตือพื้นที่ยังผลของการสปัตเตอร์)	136
รูปที่ 5.27ข	ภาพถ่ายของเป้าทางแดงที่ผังอินเดียน 22 เปอร์เซนต์ บนพื้นที่ยังผลของการสปัตเตอร์	136

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 5.27ค ภาพถ่ายของเป้าทองแดงที่ฝังอินเดียม 38 เปอร์เซนต์ บนพื้นที่ยังผลของการสปัตเตอร์	137
รูปที่ 5.27ง ภาพถ่ายของเป้าทองแดงที่ฝังอินเดียม 63 เปอร์เซนต์ บนพื้นที่ยังผล ของการสปัตเตอร์ (ขณะติดบนแหล่งกำเนิดการสปัตเตอร์)	137
รูปที่ 5.28 ภาพวาดแสดงการวางวัสดุรองรับเมื่อมองจากด้านบน	139
รูปที่ 5.29 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพด้านทันทีไฟฟ้าของพิล์มกับพื้นที่ อินเดียมบนเป้า	141
รูปที่ 5.30 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของพิล์มบางจากเป้าแบบต่างๆ	142
รูปที่ 5.31 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ผลลัพธ์ของทองแดงกับเปอร์เซนต์ ของอะตอมอินเดียมที่เป็นตัวถูกละลาย	144
รูปที่ ผ-1 ภาพจำลองการชนของอนุภาคทรงกลมแข็ง 2 อนุภาค ตามแบบจำลองลูกบิลเลียด	157
รูปที่ ผ-2 ภาพจำลองการชนแบบไม่มีดีดหยุ่น	160
รูปที่ ผ-3 ภาพถ่ายของอุปกรณ์วัดความเข้มสนามแม่เหล็ก	164
รูปที่ ผ-4 แสดงการวางหัววัดแม่เหล็กเพื่อวัด B_x	165
รูปที่ ผ-5 แสดงการวางหัววัดแม่เหล็กเพื่อวัด B_y	165
รูปที่ ผ-6 หลักการจัดอุปกรณ์วัดความหนาโดยวิธีไอลานสกี	166
รูปที่ ผ-7 ภาพถ่ายของระบบวัดความหนาของพิล์มบางโดยวิธีไอลานสกี	168
รูปที่ ผ-8 ผลการระบุตำแหน่งของริ้วรอยการแทรกสอดจากการอ่าน บนจุดคอมพิวเตอร์	168